

北京集创北方科技股份有限公司总裁谭云龙：

以长期主义攻关核心技术，实现显示产业跨越式发展

《电子信息制造业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)的发布,为我国电子信息产业擘画了新蓝图。其中,在“加快消费电子创新发展”部分,明确提出布局空间计算、显示光学、感知交互等关键技术,突破高端音视频处理芯片、显示模组等关键部件。这对显示产业而言,既是重大机遇,更是时代使命。

显示是数字世界的“第一界面”,也是人机交互的核心入口。

从智能手机到智能座舱,从巨幕影院到AR眼镜,人类获取的信息七成以上来自视觉。显示产业实力的强弱,直接关系到消费电子全球竞争力,关系到数字经济的底座是否牢固。

经过多年深耕,我国已成为全球显示产业的重要一极——面板产能全球领先,LED显示惊艳世界,显示驱动芯片加速突破。但我们必须清醒看到,在高端显示芯片、核心材料、先进设备等领域,依然存在短板。《规划》强调“提升全链条供给能力”,正是要打通从关键部件到场景应用的“任督二脉”。

未来五年,我认为显示产业将呈现三大发展趋势:

第一,显示与计算深度融合。AI终端和空间计算的兴起,正在重新定义显示——它不再是被动的输出窗口,而是集感知、计算、交互于一体的智能节点。显示芯片,也将从“驱动器件”进化

为“算力节点”。

第二,产业链竞争从单点比拼转向生态竞争。没有任何一家企业能独善其身,面板、芯片、材料、终端、应用各方必须协同共进。《规划》提出“强化产业链协同”,切中了产业升级的要害。

第三,我国显示产业从“跟跑”向“领跑”跨越。在部分领域我们已经领先,在更多前沿领域我们正在并跑。“十五五”时期将是我国显示产业确立全球竞争优势的关键窗口期。

我们深知,“缺芯”曾是中国显示产业的痛点,攻克核心技术是我们这一代人的责任。北京集创北方科技股份有限公司坚持自主创新,

在多个细分领域实现了突破;同时积极布局下一代显示技术,为空间计算时代储备能力。

面向“十五五”,我有三点感悟:

一是坚持长期主义。显示产业是厚积薄发的产业,核心技术攻关需要“十年磨一剑”的定力,不为短期利益诱惑,不因周期波动动摇。

二是深化协同创新。上下游企业应打破壁垒,在标准制定、技术攻关、场景落地等方面深度合作,构建自主可控、开放共赢的产业生态。

三是拥抱全球化。中国显示产业的发展离不开世界,世界显示产业的进步同时需要中国。我们要在开放中提升竞争力,在合作中实现新跨越。

北京奕斯伟计算技术股份有限公司董事长、CEO 米鹏：

以“RISC-V+AI”为底座，筑牢AI时代算力根基

近日,工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《规划》,特别提出“推进第五代精简指令集(RISC-V)研发与产业化,支持RISC-V芯片在人工智能、嵌入式系统等领域应用”,让我们深受鼓舞。

七年前,当北京奕斯伟计算技术股份有限公司(以下简称“奕斯伟计算”)选择RISC-V作为核心技术路线时,行业还在争论这一架构“能不能用”;七年后,行业已经用实际行动证明了它的产业价值。我们深刻认识到,RISC-V不再仅仅是一个“备选方案”,而是承载AI时代算力底座重任的“战略选择”。结合《规划》精神和奕斯伟计算七年来的产业实践,我们有以下几点思考和行动。

筑基强链:以RISC-V开源开放架构破解底层技术难题。

《规划》将“筑牢产业基础能力”置于重点任务之首,明确要求“推动集成电路全链条攻关”,发展高性能处理器等高端芯片产品。中国集成电路产业面临两个难题:一是制造端的精密度问题,二是产品端的底层技术问题。

在x86与Arm架构长期主导的全球芯片市场中,RISC-V凭借开源开放、灵活、模块化、高能效等特性,被认为是AI时代原生计算架构,正

成为AI时代计算架构第三极。

根据弗若斯特沙利文数据,中国RISC-V主控芯片市场规模已经由2021年的11亿元增长至2025年的377亿元,年复合增长率高达139.5%,预计2030年将达到2194亿元,成长空间巨大。

就我们自身而言,截至2026年3月末,奕斯伟计算已有逾150款用于人机交互与多媒体处理、互连与计算的软硬协同产品实现商业化,服务全球220家客户;技术储备包括620余个IP模块、20余个系列化RISC-V内核,以及1740余项专利申请。基于丰富IP库与自研系列RISC-V内核,奕斯伟计算构建了软硬件深度协同能力,为多领域AI算力部署筑牢底层根基,在多个领域落地RISC-V产品及方案。

芯模协同:以“RISC-V+AI”深度融合夯实人工智能硬件底座。

《规划》在“培育产业发展新增长点”中明确提出“夯实人工智能硬件底座”,要求加强人工智能芯片与整机产品协同,面向具身智能、自动驾驶等领域开发端侧推理设备及芯片,深化芯模协同创新。

自创立以来,我们就坚定走“RISC-V+AI”技术路线,这一长期布局与《规划》提出的芯模协

同创新方向高度契合。立足“端-边-云”智能产业演进趋势,我们坚持算力和算法的深度融合与协同优化,打通芯片算力与智能模型之间的适配链路,让硬件平台与智能算法形成完整的体系化支撑。依托这套思路,我们较早完成DeepSeek等国产大模型在自研RISC-V平台上的适配验证,打造面向多元端边云场景的统一算力底座,为智能连接、智能座舱、智能计算等应用落地筑牢硬件支撑,在持续的产品实践中不断验证“RISC-V+AI”的产业潜力。

在具体实践中,我们基于RISC-V架构打造的车规级电子后视镜专用芯片EAI8800,单芯片中集成了传统方案需要3颗芯片才能实现的功能,端到端延时控制在20毫秒以内。这正体现了RISC-V在定制化、高能效场景中的独特价值。

生态共建:以开放协同推动RISC-V从“备选”走向“主流”。

《规划》在“增强产业可持续发展能力”中强调“全面提升自主创新能力”“构建对外开放合作新格局”。RISC-V与生俱来的开放属性,决定其不能沿袭封闭发展的路径。目前,这一架构正跻身主流计算架构行列,为中国半导体产业带来架构革新的历史机遇。

要把握这一时代机遇,单靠企业个体力量难以实现,亟须产业链开放协作、共建完整产业生态。为此,奕斯伟计算率先提出RISC-V数字基础设施(RDI)产业概念,倡导将RISC-V应用于数字基础设施的各个层面,并牵头成立RDI聚力联盟,现联盟成员已近百家,覆盖产业链上下游,并推动在北京、武汉、成都、西安等地设立RDI创新中心,形成多地联动;与此同时,公司打造RISAA(RISC-V+AI)生态技术平台,将RISC-V计算架构与AI技术深度融合,协同产业链伙伴推动RISC-V在各类垂直场景的落地,不断拓展RISC-V应用场景边界,持续完善产业软硬件生态与标准体系,同时深度参与全球RISC-V标准制定,提升我国开源计算架构领域的产业话语权。

随着《规划》的落地实施,RISC-V产业将迎来从政策支持到市场驱动的加速期。我们相信,当AI从训练走向推理、智能体从数字走向物理、RISC-V从备选走向主流,三重变革将同频共振,汇聚成推动AI产业跃迁的磅礴动能。奕斯伟计算将继续以“RISC-V+AI”为战略锚点,与产业链上下游伙伴携手,以RISC-V为底座,共同筑牢AI时代的算力根基,为中国电子信息制造业的高质量发展贡献力量。

深圳基本半导体股份有限公司总裁和巍巍：

以碳化硅之“石”，筑电子信息之“基”

近日,工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《规划》,提出到2030年规模以上企业营业收入将突破30万亿元,产业研发投入强度达到3.5%,并围绕“筑基、提质、育新、治理”部署17项重点任务。细读全文,一个鲜明信号扑面而来:以碳化硅为代表的宽禁带半导体,正从产业升级的“可选路径”跃升为电子信息制造业“筑基”环节不可或缺的“砖石”。

战略升维:从“跟跑并跑”到“筑基主力”。

《规划》在“筑牢产业基础能力”首项任务中,将“推动宽禁带半导体产业提质升级”与高端芯片、先进制程、先进封装并列部署;在“能源电子产业化提升”专栏中,又将“发展先进功率半导体”列为核心方向。两处着墨,精准切中了全球半导体向宽禁带迁移的技术大势,也回应了我国能源转型与智能制造对高效功率器件的迫切需求。

碳化硅耐高压、耐高温、高频、低损耗,是新能源汽车主驱逆变器、AI算力中心电源、光伏储

能变流器、轨道交通牵引系统实现能效跃升的核心器件。“十四五”期间,我国碳化硅产业完成了从跟跑到并跑的关键跨越。深圳基本半导体股份有限公司(以下简称“基本半导体”)作为国内少数具备芯片设计、晶圆制造、模块封装、驱动应用全链条自主能力的垂直一体化IDM企业,正是这一进程的亲历者和推动者。

我们深知,宽禁带半导体不是硅基器件的简单替代,而是一场涉及材料、工艺、封装、驱动、系统应用的全链条变革。这条路投入重、周期长、试错成本高,但《规划》让我们更加确信:关键环节的技术和产能必须握在自己手里,产业链的安全与韧性才有真正的依托。

场景牵引:从实验室到真正的“考场”。

《规划》强调“推动科技创新和产业创新深度融合”“以场景应用牵引行业电子高端化、专业化发展”。碳化硅功率器件的价值从来不是实验室中的“孤芳自赏”,它的生命力在于上车、入网、进厂——新能源汽车的主驱逆变器是考场,光伏储

能的功率变换系统是考场,当下蓬勃发展的AI数据中心电源更是考场。

近年来,基本半导体碳化硅产品已批量应用于AI算力、电动汽车、风光储能、轨道交通、工业控制、智能电网等领域。每一个场景的导入,都是一次技术迭代的倒逼;每一次客户的反馈,都推动着工艺和性能的再优化。产业需求与技术进步形成的正向循环,让我们更加坚定了扎根碳化硅功率半导体、服务能源电子与AI算力基础设施两大主战场的战略定位。

实干筑基:基本半导体的“十五五”行动。

今年7月,基本半导体在香港联交所上市,成为港股18C章首家碳化硅半导体企业,募资重点投向产线扩建与新品研发。站在新的起点上,《规划》的发布既是鼓舞,更是号角。面向“十五五”,我们将聚焦三件事:

一是坚持IDM战略不动摇。持续推进产线建设和工艺迭代,把制造环节的核心能力牢牢掌握在自己手中,不断提升良率和产能,为规模化

应用提供坚实供给。

二是聚焦两大主赛道。面向AI算力和新能源汽车,加快高端产品研发和客户导入,持续拓展消费电子、光伏储能、工业控制、智能电网等应用场景,形成覆盖高、中、低功率的完整产品矩阵,用更优的性能和成本响应下游需求。

三是坚持开放合作。积极参与国家和行业标准制定,加强与上下游企业的协同创新,构建产业生态共同体,让更多伙伴在宽禁带半导体的赛道上共享成长。

“十五五”大幕已启,30万亿元的产业蓝图令人振奋。基本半导体的角色很清晰:做产业基础能力筑牢过程中一块靠得住的“碳化硅”砖石。我们这一代半导体人,赶上了本土化发展、与全球能源变革叠加的黄金窗口,唯有扎下去、做出来,才不负时代。基本半导体愿与产业链伙伴一道,为电子信息制造业高质量发展、为制造强国和网络强国建设,贡献宽禁带半导体的坚实力量。